

拒絶理由通知書

特許出願の番号 平成11年 特許願 第372166号
起案日 平成13年 9月27日
特許庁審査官 柴沼 雅樹 7523 3S00
特許出願人代理人 安富 康男(外 2名) 様
適用条文 第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記 of 刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

請求項 1 - 9

引用文献 1, 2

引用文献1には、「炭素を含有する樹脂、例えばフェノール樹脂等の有機樹脂の粉末」を添加して焼結成形した結晶質のカーボンを含有する半導体製造・検査装置用セラミック基板が記載されている。そして、引用文献2には、フェノール樹脂を添加して焼結成形した非晶質カーボンを含有するセラミックスが記載されている。

同じフェノール樹脂を炭素源として使用して引用文献2記載のように非晶質カーボンを含有するセラミックスも得られること、および一般的にカーボンの結晶質の割合(結晶化する度合)は連続的に各段階が存在することに鑑みれば、引用文献1記載のものにおいても、「レーザラマンスペクトルによる分析において、 1580 cm^{-1} 付近および 1355 cm^{-1} 付近にピークが出現するカーボンを含む」しているものと認められる。

また、「前記 1580 cm^{-1} 付近のピークと前記 1355 cm^{-1} 付近のピークとのピーク強度比： $I(1580)/I(1355)$ が3.0以下」、「 1355 cm^{-1} 付近のピークの半値幅(半値全幅)が 20 cm^{-1} 以上」などの限定に格別の臨界的意義も認められないから、これらの限定は当業者の容易に想到し

えたことと認められる（同じ出願人による特許願11-372164号の明細書には、「レーザラマンスペクトルによる分析において、1580 cm⁻¹付近のピークと前記1355 cm⁻¹付近のピークとのピーク強度比：I（1580）／I（1355）が3.0を超えてなるカーボンを含有するセラミック基板」が本願発明と同様の課題・用途において有用である旨記載されている）。

静電チャック、ホットプレート、ウェハプローバなどの周知の半導体製造・検査装置用に適用した点にも、格別の困難性は認められない。

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

引用文献等一覧

① 特開平9-48668号公報

② 特開平2-6367号公報

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 IPC第7版 H01L21/68, C04B35/58, H01L21/027, H05B3/18

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由について問い合わせがあるときは、特許審査第二部組立製造（TEL03-3581-1101内線6160）までご連絡ください。